



★PETフィルムへ回路作成を実現

★PETフィルムへ部品実装を実現

★部品実装済みフィルム基板の
インサート成形を実現



FDS一体型成形品

★本サンプルはアキレス株式会社様・タカハタプレジジョン株式会社
コラボレーションにより実現できました。



インサート成形で 耐環境性の向上

部品実装済みのフィルム基板をインサート成形することは回路が流れてしまったり電子部品の損傷など懸念点が多いがタカハタプレジジョン様の技術で一体型成形を可能にしました。



フィルムを 電子基板化

耐熱温度の低いPET樹脂をフィルム基板に使用しております。アキレス様の技術で電子回路作成を可能にしました。



フィルム基板に 部品実装

通常部品実装時にかかる熱によりPETフィルム基板はダメージが出てしまうが、WFCでは部品実装を可能にしました。

